

# 검토 의견서

□ 검토자 : 정보통신공학과 현광민

개정안	검 토 의 견	
	수 정 안	사 유
제 41조(학위 논문의 심사)	<p>제 41조(학위 논문의 심사)</p> <p>① 학위 논문의 심사는 공개발표회와 논문심사로 구분하며, 논문심사에는 구술 시험을 포함한다.</p> <p>② 석사학위 논문심사는 1회 이상으로 하며, 추가로 공개발표회를 가질 수 있다.</p> <p>③ 박사학위 논문심사는 공개발표회를 가져야 하며, 공개 발표회를 포함하여 3회 이상으로 한다.</p> <p>④ 석박사 통합 과정의 경우는 박사학위 논문심사 기준을 따른다.</p>	<p>전체적으로 석사, 박사, 석박 통합과정이 혼재되어 있어 정리가 안된 것으로 보임.</p> <p>특히 ①의 경우에는 원래 1항은 예비 심사와 본 심사를 구분한 것인데, 변경 조항은 논문심사와 구술 시험을 둘다 해야 하는 것으로 보임.</p> <p>즉, 석사, 박사, 석박 통합 모두 논문 심사와 구술 시험을 별개로 진행한다는 의미로 보임.</p> <p>특히, 공개발표회를 하는지 안하는지, 심사에 포함하는지 안하는지 등에 대한 정의가 혼재되어 있음</p> <p>이 조문에 대한 명확한 정의를 해야 할 필요가 있음.</p>

<p>제 48조(학위수여 요건)</p>	<p>제 48조(학위수여 요건)</p> <p>② 석박사 통합과정을 이수중이거나 수료 또는 중도 포기자가 석사학위 취득을 요청할 경우에는 이 규정에서 정한 석사 과정 취득 관련 절차와 요건에 관한 조문을 적용하여 석사학위 수여 조건을 충족할 경우에는 석사학위를 수여할 수 있다.</p>	<p>② 항의 석박사 통합과정을 포기한 경우 석사학위를 받는 것에 대해 표현이 미흡해 보임.</p> <p>즉, 전공 시험, 논문 계획서, 논문 심사의 절차와 내용을 따라야 한다는 것을 명기해야 할 것으로 보임.</p>
-----------------------	--	---

<p>[별표 1]</p> <table border="1" data-bbox="143 1164 582 1534"> <tr> <td data-bbox="143 1164 287 1534"> <p>학연 협동과정</p> </td> <td data-bbox="287 1164 438 1534"> <p>스 마 트 인 프 라 방재 연 구소(방재 공학,토목 공학,대기 환경과학, 전자공학, 통계학)</p> </td> <td data-bbox="438 1164 582 1534"> <p>스 마 트 인 프 라 방재 연 구소(방재 공학,토목 공학,대기 환경과학, 전자공학, 통계학)</p> </td> </tr> </table>	<p>학연 협동과정</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 연 구소(방재 공학,토목 공학,대기 환경과학, 전자공학, 통계학)</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 연 구소(방재 공학,토목 공학,대기 환경과학, 전자공학, 통계학)</p>	<p>[별표 1]</p> <table border="1" data-bbox="622 1097 1061 1601"> <tr> <td data-bbox="622 1097 766 1601"> <p>학연 협동과정</p> </td> <td data-bbox="766 1097 917 1601"> <p>스 마 트 인 프 라 방재 전 공(스마트 인 프 라 방재연구 소,방재공 학,토목공 학,대기환 경과학,전 자공학,통 계학)</p> </td> <td data-bbox="917 1097 1061 1601"> <p>스 마 트 인 프 라 방재 전 공(스마트 인 프 라 방재연구 소,방재공 학,토목공 학,대기환 경과학,전 자공학,통 계학)</p> </td> </tr> </table>	<p>학연 협동과정</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 전 공(스마트 인 프 라 방재연구 소,방재공 학,토목공 학,대기환 경과학,전 자공학,통 계학)</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 전 공(스마트 인 프 라 방재연구 소,방재공 학,토목공 학,대기환 경과학,전 자공학,통 계학)</p>	<p>의 내용에서 "스마트인프라연구소"는 학과나 전공이 될 수 없음. 스마트인프라연구소가 어떤 기관인지 알수는 없지만, 학과명, 전공명으로 하는 경우에는 수정해야 할 것으로 보임</p>
<p>학연 협동과정</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 연 구소(방재 공학,토목 공학,대기 환경과학, 전자공학, 통계학)</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 연 구소(방재 공학,토목 공학,대기 환경과학, 전자공학, 통계학)</p>						
<p>학연 협동과정</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 전 공(스마트 인 프 라 방재연구 소,방재공 학,토목공 학,대기환 경과학,전 자공학,통 계학)</p>	<p>스 마 트 인 프 라 방재 전 공(스마트 인 프 라 방재연구 소,방재공 학,토목공 학,대기환 경과학,전 자공학,통 계학)</p>						